

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-028

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为每股28.03元。本次发行募集资金总额为人民币617,594,352.02元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为544,497,129.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15561号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 353,050,519.51 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2023 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	617,594,352.02
减：保荐及承销费用	46,278,925.58
实际银行到账余额	571,315,426.44
减：募集资金项目投入	13,187,836.72
发行费用	136,158.32
以闲置募集资金购买理财产品	205,000,000.00
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
募集资金专项账户手续费支出	225.00
注销募集账户利息余额转出	-
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	-
募集资金理财产品利息收益	-
募集资金专项账户存款利息收入	59,313.11
募集资金专项账户余额	353,050,519.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2023 年 12 月，公司与保

荐机构华泰联合证券有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中华园支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司共有4个募集资金专户和3个通知存款账户，本年度募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
江苏艾森半导体材料股份有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	391064700013000424409	781,246.28	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	51433700001579	13,603,114.42	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	昆山农村商业银行中华园支行	2010020247364	55,163,687.26	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000714459	13,502,471.55	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	391899999603000019728	210,000,000.00	7天通知存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	52197300000476	30,000,000.00	7天通知存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	86033000000141770	30,000,000.00	7天通知存款
合计		/	353,050,519.51	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2023年度公司实际募集资金项目投入13,187,836.72元，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,364.49万元，公司以自筹资金累计支付发行费611.23万元，尚未进行置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金	已预先投入金额
年产 12,000 吨半导体专用材料项目	21,076.83	18,592.45
集成电路材料测试中心项目	28,372.88	5,772.04
发行费用	-	611.23
合计	49,449.71	24,975.72

注：2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金24,364.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金611.23万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年2月6日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-011）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年12月9日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型

理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，公司董事会及监事会同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年12月12日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-002）。

2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额	产品期限（天）	产品起始日	产品到期日	预计收益率	实际收益金额
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2023年第2874期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	354	2023/12/18	2024/12/6	1.9%或2.77%或2.87%	未到期
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2023年第2875期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	184	2023/12/18	2024/6/17	1.7%或2.67%或2.77%	未到期
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2023年第2140期标准化结构性存款	保本浮动收益型	500.00	7	2023/12/29	2024/1/5	1.7%或2.45%或2.55%	未到期
昆山农村商业银行中华园支行	昆山农商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	106	2023/12/14	2024/3/29	1.3%或2.8%或3.0%	未到期
昆山农村商业银行中华园支行	昆山农商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	358	2023/12/14	2024/12/6	1.3%或2.8%或3.0%	未到期

注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度江苏艾森半导体材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2023年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华泰联合证券有限责任公司认为：截至2023年12月31日，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对公司在2023年度的募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				54,449.71		本年度投入募集资金总额				1,318.78		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,318.78		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产12,000吨半导体专用材料项目	否	21,076.83	21,076.83	21,076.83	-	-	-21,076.83	-	不适用	不适用	不适用	否
集成电路材料测试中心项目	否	28,372.88	28,372.88	28,372.88	668.48	668.48	-27,704.40	2.36	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	650.31	650.31	-4,349.69	13.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	54,449.71	54,449.71	54,449.71	1,318.78	1,318.78	-53,130.93	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本专项报告之三、（二）						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本专项报告之三、（四）						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金节余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，不包含未置换的使用自筹资金投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。